

# パワーデバイス用高耐熱エポキシ材料

## High heat-resistant epoxy compounds for power device

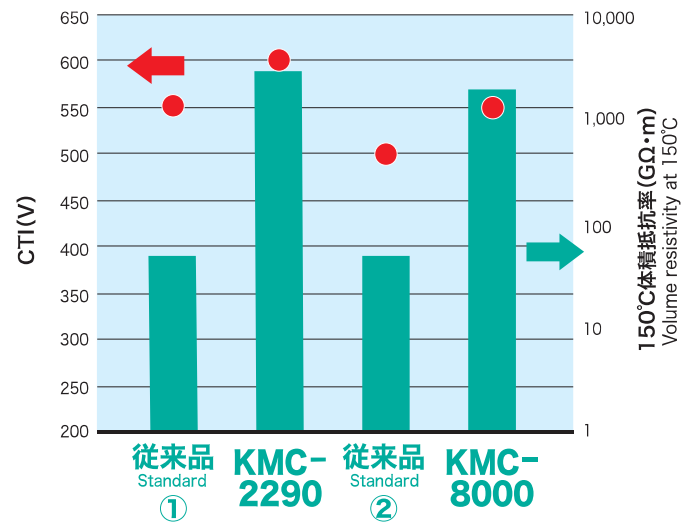
### トランスファー成形材料(KMC)

Transfer molding materials (KMC)

## CTI 600V達成、高パワーサイクル耐性、高温時リーク対策

Achieve CTI 600V, Resistant high power cycle, Prevent leakage at high temperature

	従来品 Standard ①	KMC- 2290	従来品 Standard ②	KMC- 8000
特長 Feature	高CTI High CTI		高耐熱 High heat-resistance	
形態 Form	タブレット Tablet			
熔融粘度 (175°C) (Pa·s) Melt Viscosity	15	15	15	10
Tg (°C)	160	160	250	300
CTI (V)	550	600	500	550
150°C 体積抵抗率 (GΩ·m) Volume resistivity at 150°C	50	3,000	50	2,000



### 2液ポットイング材料 SMC-8750

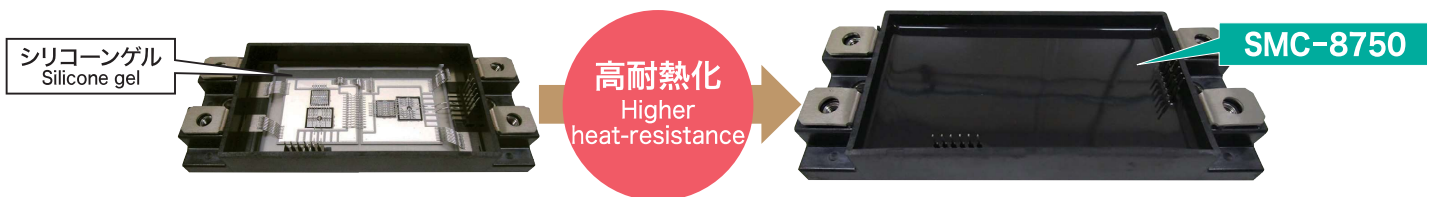
2 component potting material

## 常温保管、高耐熱性 (165°C硬化: Tg220°C)

Store at room temperature, High heat-resistance (165°C cure: Tg 220°C)

## 低透湿性、高強度 (リッドフリー)

Low moisture permeation, High strength (lid free)



	従来品 (シリコンゲル) Standard (silicone gel)	SMC-8750
水蒸気透過率※ Moisture permeation rate (g/m <sup>2</sup> ·24h)	>100	0.2

※厚さ: 1.0mm  
Thickness

※40°C 90% RH

### パワーサイクル Power cycle

